

组装缺陷与对策

杭州迅得电子
一站式电子组装加工服务商
官网: www.exunde.com
浙江省杭州市余杭区五常大道163号C栋1-2层
业务联系: 18958095137; 18969959650



加业务员微信了解更多

不良项目	不良内容	原因	对策
未熔融	 焊锡有一部份在固定的地方不熔化	基板的背面有吸热性很大的零件	变更设计, 提高回流焊温度
	在不定的地方不定时的不熔化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 温度曲线不合适 2. 锡膏过期 3. 印刷环境不良 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 调整适当的温度曲线 2. 使用保管适当、在使用期限的锡膏 3. 调整适当的印刷环境
焊锡量不足	 焊锡接合的地方, 焊锡量不平均	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未使用钢网开口适应的锡膏 2. 焊锡膏粘性和印刷参数不恰当 3. 钢网设计不合理 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用与钢网开口相适应的锡膏 2. 调整印刷参数, 选择适当的锡膏 3. 重新设计钢网, 使宽厚比及面积比更加合理
润湿性不足	焊盘润湿扩散性不佳	<ol style="list-style-type: none"> 1. 焊盘氧化 2. 锡膏活性太弱 3. 预热中氧化 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化裸板的管理, 避免焊盘氧化 2. 提高锡膏的活性 3. 调整适当温度或使用氮气炉
	焊锡的较平部位的润湿扩散性不佳	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sn-Cu层显露出来 2. 锡膏活性太弱 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化较平部位的膜厚度 2. 提高锡膏的活性
	零件的铅部的润湿变干状况不佳	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电镀状态不佳 2. 锡膏活性太弱 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用好的电镀零件 2. 提高锡膏的活性
桥连	 相邻的铅通过焊锡连接起来	<ol style="list-style-type: none"> 1. 锡膏的印刷量太多 2. 锡膏坍塌性较大 3. 钢网开口设计不合理 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 印刷量要适中, 调整印刷机参数 2. 使用坍塌性较小的锡膏 3. 重新设计钢网开口
立碑	 片状零件的电极有一边没接好, 导致零件竖立起来	<ol style="list-style-type: none"> 1. 焊盘氧化太大 2. 印刷量不均匀 3. 贴片时的差距太大 4. 焊盘设计不合理 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高预热温度 2. 调整印刷参数 3. 提高装载精准度 4. 修改PCB设计
锡珠	焊盘产生锡球	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预热中的氧化太大 2. 锡膏的活性较弱 3. 锡膏的坍塌性太大 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 调整成正确的温度 2. 提高锡膏的活性 3. 使用坍塌性较小的锡膏
	片状零件的侧面产生焊锡球	<ol style="list-style-type: none"> 1. 锡膏坍塌性较大 2. 锡膏印刷量太多 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用坍塌性较小的锡膏 2. 印刷量要适当
元件位置不对	元件位置没有接合好	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贴片的精准度不佳 2. 回流焊炉的链条倾斜太大 3. 锡膏活性太高使元件自行排列效果不佳 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 调整装载精准度 2. 调整设备参数 3. 降低锡膏活性
	贴片时元件乱飞没装好	<ol style="list-style-type: none"> 1. 锡膏的黏着力太弱 2. 贴片时的振动太大 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用黏着力较强的锡膏 2. 调整设备参数
灯蕊状	 熔于引脚上的焊锡往上爬	<ol style="list-style-type: none"> 1. 焊盘氧化 2. 加热过于急促 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化裸板管理 2. 调整适当的温度
ICT检查不良	 引脚接触不良	<ol style="list-style-type: none"> 1. 助焊剂残渣黏住 2. 引脚压力太低 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 调整使用低残渣的锡膏 2. 调整适当的压力